

主要特点

射频/本振频率： 4-9 GHz

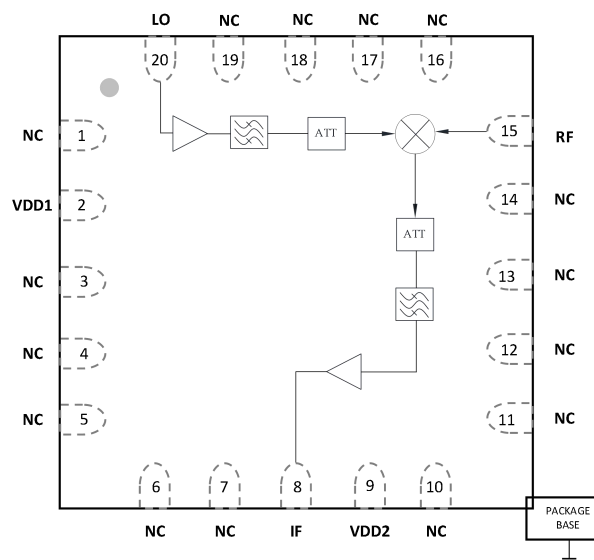
中频频率： 0.1-2 GHz

变频增益： 5.5 dB

P1dB： +15 dBm

陶封尺寸： 20 Lead, 9mm ×9mm QFN

引脚示意图

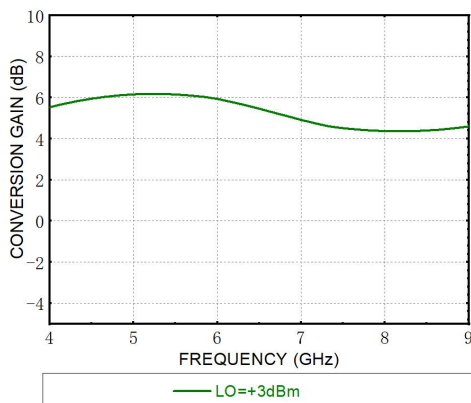


性能指标

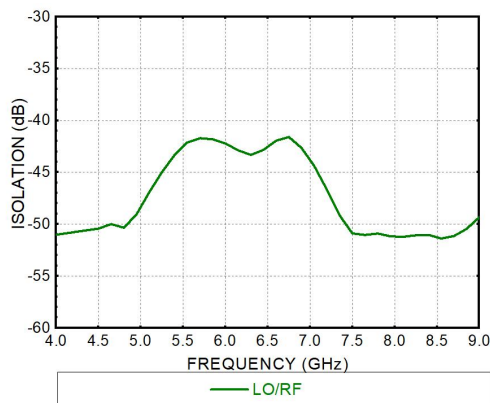
($T_A = +25\text{ }^\circ\text{C}$, $VDD1=VDD2= +5\text{V}$, $RF= -20\text{dBm}$, $IF=500\text{MHz}$, $LO= +3\text{dBm}$)

参数	VDD1=VDD2=+5V			单位
	最小	典型	最大	
射频/本振频率 (RF/LO)	4 - 9			GHz
中频频率	0.1 - 2			GHz
变频增益		5.5		dB
增益平坦度	±1.5			dB
输出功率 1dB 压缩点		15		dBm
工作电流		140		mA

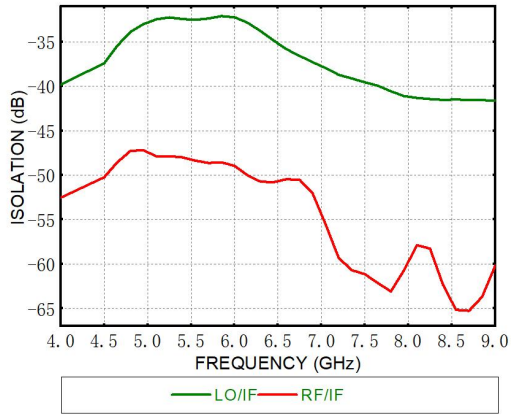
变频增益



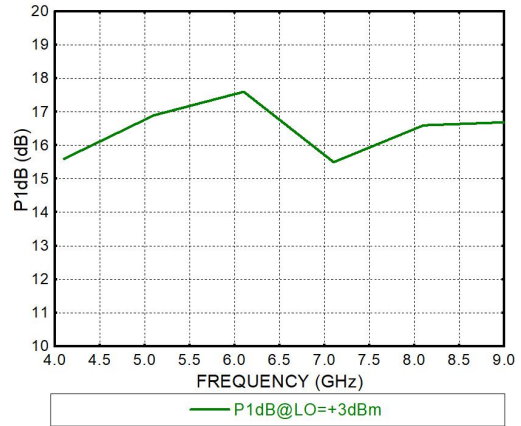
隔离度



隔离度



输出功率P1dB



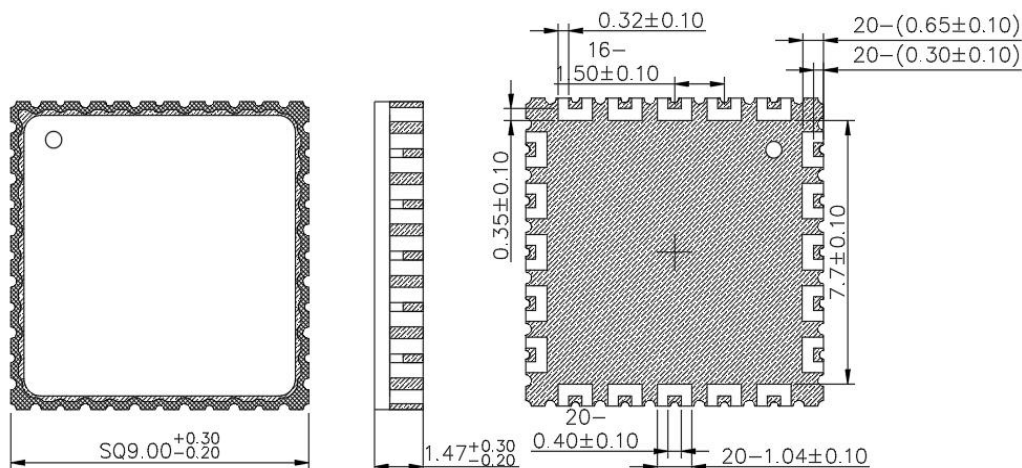
杂散抑制

下变频	nLO				
mRF	0	1	2	3	4
0	XX	15	60	56	63
1	56	0	>75	>75	>75
2	>75	>75	67	>75	>75
3	>75	>75	>75	>75	>75
4	>75	>75	>75	67	>75

RF=5GHz@-20dBm
 LO=6GHz@3dBm
 所有值为 1×LO-1×IF=RF 的相对值 (dBc)

物理参数

单位：mm



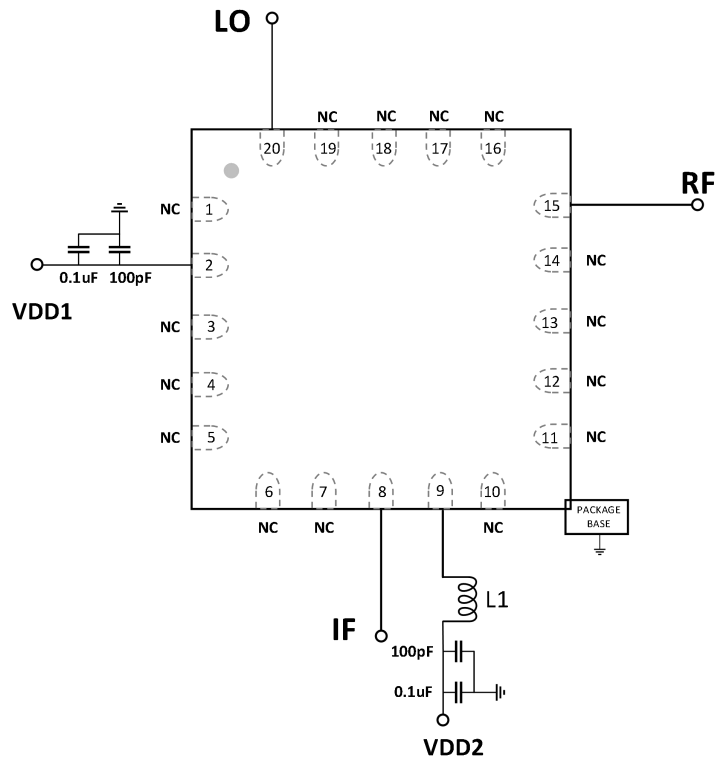
注意事项：

- 1、 器件在干燥、氮气环境中存储；
- 2、 器件对静电敏感，在储存、运输、装配和使用过程中注意防静电；
- 3、 所有接地引脚请连接RF/DC地；
- 4、 该产品适用于回流焊安装工艺，回流焊温度 $\leq 265^{\circ}\text{C}$ ，回流焊使用时需要做去金预处理。

引脚描述

引脚序号	功能	描述
2	VDD1	本振端放大器馈电端口，+5V 供电
8	IF	该引脚是 AC 耦合，并匹配至 50Ω
9	VDD2	外接偏置电路馈电，+5V 供电
15	RF	该引脚是 AC 耦合，并匹配至 50Ω
20	LO	该引脚是 AC 耦合，并匹配至 50Ω
其余	NC	接地或者悬空
底部中央焊盘	GND	底部中央焊盘背面必须连接至 RF/DC 地

推荐装配图



中频频率	30MHz	100MHz	1GHz	2GHz
L1(nH)	820	270	82	47

极限参数

1. 电源电压: +5.5 V
2. 射频输入功率: +20dBm
3. 本振驱动功率: +10dBm
4. 储存温度: -55 ~ +125°C
5. 工作温度: -55 ~ +85°C